



会社案内

Company Profile

Accelerate New Challenges
信頼性とパフォーマンスを次世代へ



会社概要

Corporation profile

社名	株式会社 YGK
住所	〒400-0311 山梨県南アルプス市曲輪田 595-2 TEL.055-284-6866 FAX.055-284-6867
設立	1994年4月
代表取締役	深津 邦夫
資本金	2,500万円
業務内容	業務内容／半導体用ウエハ検査装置の設計～販売 その他各種検査装置の設計～販売 静電気関連／気中・液中パーティクル検査装置の設計～製造



Company	YGK CORPORATION
Location	595-2, Kuruwada, Minami-Alps city, Yamanashi, 400-0311 Japan.
Telephone	TEL. 055-284-6866, FAX. 055-284-6867
Established	April 1994
President	Kunio Fukatsu
Capital	JP ¥ 25,000,000
Products	Inspection system for semiconductor

主要取引先（納入先）

国立極地研究所／福岡大学／山梨大学／アルプス電気／TDK／ディスコ／信越化学工業／住友電気工業／デンソー／三井化学／ローム／富士電機／ソニーセミコンダクタ

会社沿革

1994年4月	創立（旧櫛形町小笠原にて創業） Particle Counter 関連商品開発
1997年	新工場（現在所在地）完成・移転 基板異物検査装置開発
2003年	工場増築
2007年	ウエハエッジ検査装置開発
2009年	透明基板用高精度表裏分離検査装置開発
2010年	ロールTOロール検査装置開発
2011年	新工場増築 小型ハンディーパーティクルカウンタ開発
2012年	やまなし産業大賞受賞
2013年	小型パーティクルスキャナ YPI-MN 開発
2014年	YPI-MX-DC SiC / GaN ウエハ表面パーティクルスキャナ開発
2017年	YPI-MX-DC レーザ高精度制御開発
2020年	YPI-MX TF テープフレームウエハ表面パーティクルスキャナ開発
2022年	YPI CE 取得
2023年	工場増築
2024年4月	株式会社山梨技術工房から株式会社 YGK へ社名変更
2024年	XGS ガラス基板研磨確認装置開発

検査関連製品 | Products for particle inspection



当社は長年にわたり、各産業や大学・研究所にパーティクル測定関連の装置を提供しております。近年は半導体関連向けのウエハ表面パーティクル検査を中心に業務展開しており、検査対象ウエハは、シリコンウエハだけでなく、先端化合物ウエハで見られる透明や半透明ウエハにも対応し、半導体、MEMS、センサーなど幅広い業界への納入実績があります。

また環境関連業界には、大気汚染分析用の大気パーティクル分析装置を納入しており、様々な業界で弊社パーティクル検査装置をご使用頂いております。

We have been manufacturing particle inspection systems for industrial applications for many years. Recently, we have expanded our projects into the semiconductor field and have produced the wafer surface inspection systems with advanced laser and optical technologies.



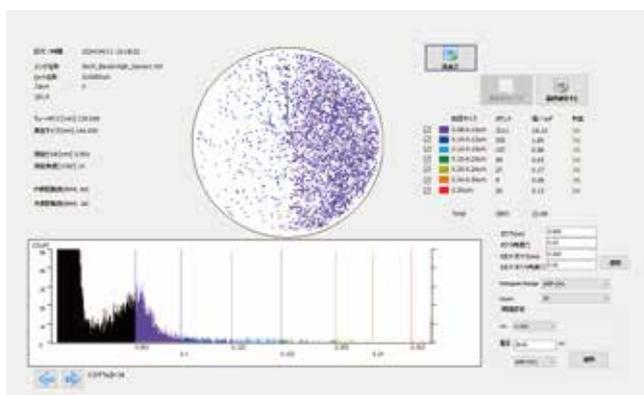
ノンパターンウエハ・ガラス基板表面検査装置

Unpatterned wafer / glass substrate inspection system

ウエハ表面パーティクルスキャナ YPI-MX-DC

Wafer surface particle inspection system YPI-MX-DC

355nm レーザ搭載、次世代パワーデバイス用 SiC/GaN ウエハ対応モデル。透明系次世代ウエハの表裏面分離技術をさらに進化させ、高感度に SiC ウエハ表面のパーティクルやスクラッチを検出します。SiC ウエハ製造の出荷検査、パワー半導体製造ラインのプロセスモニターや洗浄工程の確認に最適な装置です。SMIF 搬送システムにも対応可能です。



The YPI-MX-DC is designed to detect particles and shallow scratches on the surface of silicon carbide and gallium nitride wafers with high sensitivity, and is suitable for process monitoring and wafer cleaning process in power device semiconductor manufacturing as well as is suitable for delivery inspection in silicon carbide wafer manufacturing.

ウエハ表面パーティクルスキャナ YPI-MN

Wafer surface particle inspection system YPI-MN



マニュアル搬送のウエハ表面異物検査装置です。洗浄装置の横や、研究施設など小さなスペースでのパーティクル測定に最適です。200mm 以下のウエハやガラス基板など、様々な形状・材質のパーティクル測定に対応致します。

Particle inspection for various types of wafers up to 200mm is possible. The YPI-MN is designed in a compact style, making it ideal for laboratory use and small spaces.

ウエハ表面パーティクルスキャナ YPI-MX

Wafer surface particle inspection system YPI-MX

200mm 以下のウエハで運用される、半導体製造やウエハ製造の量産ライン用ウエハ表面検査装置です。プロセスモニターやウエハ出荷検査に最適です。シリコンウエハだけでなく、透明や半透明基板（裏面梨地片面研磨）化合物半導体ウエハの表面パーティクルの測定も対応可能です。

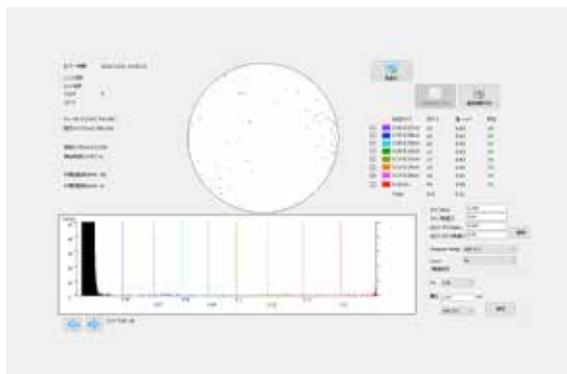
The YPI-MX is particle inspection for mass production in semiconductor, and for wafer manufacturing up to 200mm wafers. The system has an advanced surface isolation function which is suitable for transparent and opaque wafers.



ウエハ表面パーティクルスキャナ YPI-MX FOUP

Wafer surface particle inspection system YPI-MX FOUP

300mm ウエハ用 FOUP オープナを搭載した、YPI-MX の拡張モデルです。OHT やオンラインなど多様なシステム運用ができます。



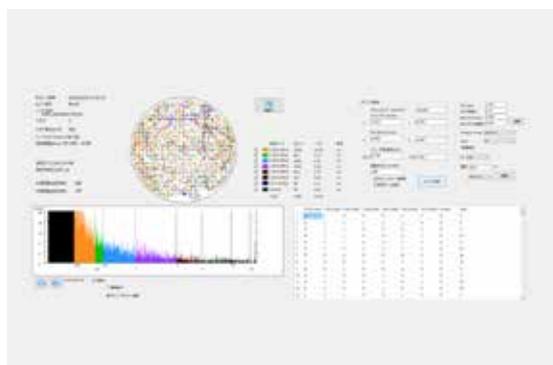
The YPI-MX FOUP is an expansion model of YPI-MX that equipped with FOUP opener system for 300mm wafer, enabling various system operations, such as OHT and online communication.

ダイシングウエハ表面パーティクルスキャナ YPI-MX TF

Dicing wafer surface inspection system YPI-MX TF

YPI-MX TF は、テープフレームに貼られたウエハのパーティクル測定が可能な YPI-MX の拡張モデルです。後工程プロセスや後工程装置の開発モデルとして最適です。ダイシング後のウエハのパーティクル測定や保護膜剥離後のウエハ表面糊残渣を確認できる装置です。マニュアル搬送セミオート機は、テープフレームウエハだけでなく、通常のウエハも測定可能です。

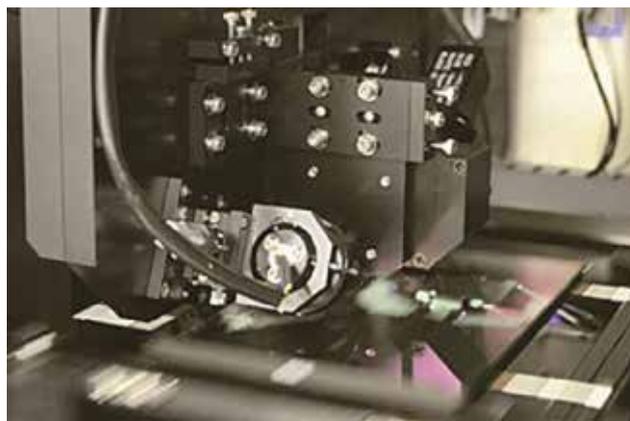
The YPI-MX TF is an expansion model of YPI-MX, capable of measuring particles on the diced wafer mounted on a tape frame. The system is ideal for developing both back-end process and process equipment. The manual loading of semi-auto model can handle tape frame wafers as well as wafers.



ペリクルフィルムパーティクルスキャナ YPI-MX-P

Pellicle film particle inspection system YPI-MX-P

マスク基板を保護するペリクルフィルムのパーティクルを測定する装置です。ペリクルフィルムを高感度に測定でき、ケースに入れたまま搬送可能なモデルなど多彩な搬送に対応可能です。



ガラス基板研磨確認装置 XGS

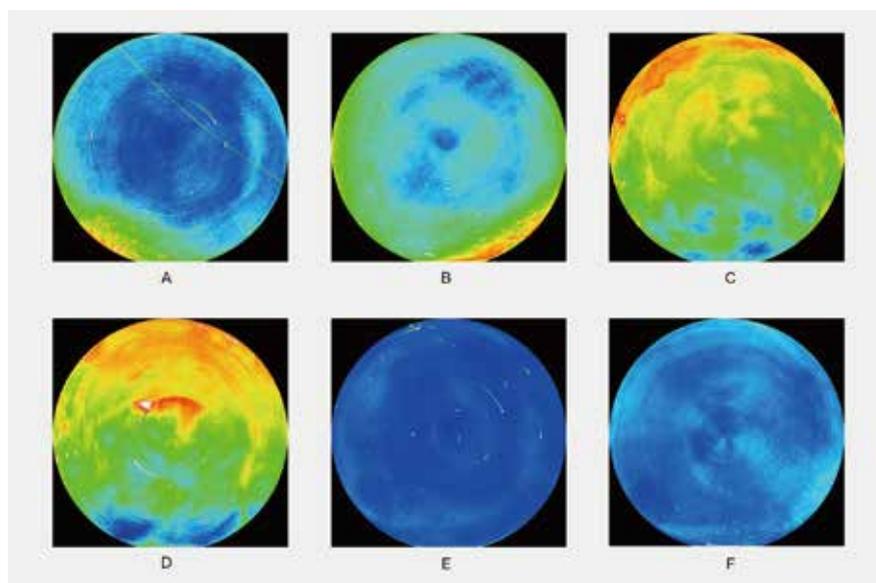
Glass substrate polishing inspection system XGS

XGS はガラス基板の研磨状態を確認できる装置です。
ガラス基板全面を非接触検査で高速に検査します。



The XGS is polishing quality inspection system for glass wafers. The system can perform "non-contact" , "high-speed" inspection of entire surface of glass wafers.

研磨出来栄を比較検査で確認できます。





株式会社 YGK

URL: <https://www.ygkcop.com>

〒400-0311 山梨県南アルプス市曲輪田595-2

TEL: 055-284-6866 FAX: 055-284-6867



Offical Web Site

